****

|  |  |
| --- | --- |
| **Reader Enquiries:** | **Press Contact:** |
| **congatec AG** | **SAMS Network**  |
| Christian Eder | Michael Hennen |
| Phone: +49-991-2700-0 | Phone: +49-2405-4526720 |
| info@congatec.com[www.congatec.es](http://www.congatec.es)  | info@sams-network.com[www.sams-network.com](http://www.sams-network.com) |



*Texto y foto también disponible online en:* [*https://www.congatec.com/es/congatec/notas-de-prensa.html*](https://www.congatec.com/es/congatec/notas-de-prensa.html)

**Nota de prensa**

congatec presenta nuevas soluciones de refrigeración para el
ecosistema de servidor edge de 100 vatios

**Manteniéndolo fresco**

**Deggendorf/Nuremberg, Alemania, 25 de febrero de 2020 \* \* \*** congatec, proveedor líder de placas y módulos informáticos embebidos estandarizados y personalizados, presenta tres soluciones de refrigeración para el nuevo ecosistema de servidor de 100 vatios que se está construyendo alrededor de los nuevos procesadores integrados AMD EPYC . Con robustas soluciones de refrigeración y módulos de procesador para funcionar las 24 horas del día, los 7 días de la semana desde una sola fuente, los fabricantes de equipos ya no necesitan pensar en cómo diseñar un sistema de gestión del calor residual del procesador. De hecho, a menudo se incluyen recomendaciones para el diseño de ventilación del sistema, de modo que el esfuerzo de diseño térmico a nivel del sistema se reduce significativamente. Las soluciones de refrigeración perfectamente adaptadas son esenciales para el ecosistema del servidor edge de 100 vatios, ya que el sobrecalentamiento puede provocar un envejecimiento rápido y fallos del sistema. Los servidores edge con requisitos en tiempo real también necesitan una protección óptima contra la degradación del rendimiento inducida térmicamente para garantizar un comportamiento determinista, lo que subraya aún más la importancia de los sistemas de refrigeración de alto rendimiento en los sistemas informáticos industriales.

“Los procesadores AMD EPYC Embedded 3000 son los buques insignia de una nueva era de sistemas embebidos. Cumplen funciones importantes del servidor edge pero también producen más calor residual que los sistemas embebidos convencionales. Es por eso que hemos trabajado duro para crear un ecosistema de 100 vatios para módulos COM Express de alto rendimiento que cumpla con los requisitos de diseño robusto para un funcionamiento 24/7. Ahora presentamos tres de estas soluciones por primera vez en Embedded World 2020”, explica Andreas Bergbauer, Product Line Manager en congatec.

“Los procesadores AMD EPYC Embedded 3000 Series permiten una amplia gama de diseños de servidores edge embebidos. Es genial ver que compañías como congatec invierten en ofrecer un ecosistema completo con módulos SoM (Server-on-Modules) y todos los accesorios necesarios, como estas potentes soluciones de refrigeración, que ayudarán a simplificar los diseños y ayudarán a los clientes finales a obtener sistemas más rápido ", explica Stephen Turnbull, director de gestión de productos y desarrollo de negocios, Embedded Solutions, AMD.

Las soluciones de refrigeración de congatec para el ecosistema de 100 vatios alrededor de los procesadores AMD EPYC Embedded 3000 vienen en tres variantes, todas basadas en la especificación del disipador de calor COM Express que ha sido estandarizado por el PICMG, es decir, el disipador de calor con adaptador de tubo de calor; disipador de calor con tubo de calor integrado; y una solución de refrigeración activa. Junto con los disipadores de calor COM Express estándar, los OEM ahora pueden elegir entre cuatro variantes que cubren toda la gama de soluciones de refrigeración del procesador.

**Adaptador de tubo de calor para disipador térmico COM Express**

El adaptador de tubo de calor conga-B7E3 / HPA absorbe el calor residual del disipador de calor a través de hasta cuatro tubos de calor y lo dirige, por ejemplo, hacia otros disipadores de calor pasivos montados en la carcasa. Esto permite el diseño de sistemas extremadamente potentes de refrigeración pasiva de hasta 100 vatios.

**Disipador de calor COM Express con tubo de calor integrado**

La solución de tubo de calor integrado, conga-B7E3 / HSP-HP, se desarrolló principalmente para sistemas embebidos particularmente planos donde se debe acoplar a la carcasa un disipador de calor COM Express de altura estándar. Aquí, el tubo de calor integrado distribuye el calor residual del procesador de manera uniforme en todo el disipador térmico para que no se creen puntos calientes, incluso en aplicaciones con un TDP de hasta 100 vatios.

**Sistema de refrigeración activo para un funcionamiento robusto 24/7**

El sistema de refrigeración activo basado en ventilador conga-B7E3 / CSA-HP está específicamente diseñado para funcionar las 24 horas del día, los 7 días de la semana en entornos industriales hostiles. En este completo sistema de refrigeración para módulos COM Express, los ventiladores no solo se montan de manera extra segura, sino que también se fijan específicamente para reducir el desgaste. Además, los rodamientos están equipados con un sello especial y una cubierta adicional para proporcionar la máxima protección para mecánicos y lubricantes. Con un aceite sintético de alto rendimiento como lubricante, el ventilador tiene un MTBF de varias décadas, y esto en el rango de temperatura industrial desde -45 a + 85 ° C y con resistencia a golpes y vibraciones de grado industrial. El alcance funcional de este sistema de refrigeración activo basado en ventilador se completa con la integración adicional de un tubo de calor para distribuir el calor residual del procesador incluso antes de que llegue al ventilador activo.

Se puede encontrar más información sobre las soluciones de refrigeración de congatec para el nuevo ecosistema de 100 vatios que rodea los módulos informáticos COM Express basados en AMD EPYC Embedded en: <https://www.congatec.com/en/technologies/com-express/com-express-type-7/amd-epyc-embedded-3000-eco-system.html>

**Sobre congatec**congatec es una compañía de tecnológica en rápido crecimiento que se centra en productos informáticos embebidos. Los módulos informáticos de alto rendimiento se utilizan en una amplia gama de aplicaciones y dispositivos en automatización industrial, electromedicina, transporte, telecomunicaciones y muchos otros mercados verticales. congatec es el líder mundial del mercado en el segmento de módulos CoM con una excelente base de clientes desde empresas nuevas hasta compañías internacionales de primera clase. Fundada en 2004 y con sede en Deggendorf, Alemania, la compañía alcanzó ventas por 133 millones de dólares en 2018. Más información está disponible en nuestro sitio web en [www.congatec.com](http://www.congatec.com) o via [LinkedIn](https://www.linkedin.com/company/455449), [Twitter](https://mobile.twitter.com/congatecAG) y [YouTube](http://www.youtube.com/congatecAE).

\* \* \*

*AMD, the AMD logo, EPYC, and combinations thereof are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc.*